

## 芯原微电子（上海）股份有限公司

### 关于子公司涉及诉讼事项达成和解暨收到终止诉讼裁定的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

就 2019 年 11 月 19 日 Hong Kong Bite Co., Limited（以下简称“香港比特”）对芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司 VeriSilicon (Hong Kong) Limited（以下简称“芯原香港”）提起的诉讼（相关诉讼基本情况及进展已在公司科创板上市之《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及定期报告中披露），双方达成和解，且中华人民共和国香港特别行政区高等法院原讼法庭（以下简称“香港法院”）裁定该诉讼程序终止。公司就有关情况公告如下：

#### 一、关于和解及法院裁定终止诉讼的情况

双方经过友好协商，就上述诉讼签署了 Settlement Agreement（以下简称“和解协议”）。根据和解协议，双方达成自负讼费的庭外和解。

双方签署和解协议后，已就申请终止诉讼向香港法院提交同意传票，并于近日收到香港法院准予终止诉讼的裁定。香港法院裁定此诉讼案件终止，香港比特亦不能就同一诉讼理由再提起诉讼。

#### 二、本次诉讼和解对公司的影响

本次诉讼和解及香港法院裁定本次诉讼案件终止，不会对公司的日常生产经营产生负面影响，也不会对公司当期及未来的损益产生负面影响。公司遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2024年7月31日